

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2005-46996

(P2005-46996A)

(43) 公開日 平成17年2月24日(2005.2.24)

(51) Int.Cl.⁷

B81C 1/00
H01L 41/09
H01L 41/18
H01L 41/22
H01L 41/24

F I

B81C 1/00
H01L 41/22
H01L 41/08
H01L 41/08
H01L 41/18

Z
C
J
101Z

テーマコード(参考)

審査請求 未請求 請求項の数 24 O L 外国語出願 (全 19 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2004-205696 (P2004-205696)
 (22) 出願日 平成16年7月13日 (2004.7.13)
 (31) 優先権主張番号 US10/619,923
 (32) 優先日 平成15年7月15日 (2003.7.15)
 (33) 優先権主張国 米国(US)

(71) 出願人 503231882
 エージェンシー フォー サイエンス、テ
 クノロジー アンド リサーチ
 シンガポール国シンガポール、セントロス
 、ナンバーO7-01、ビオポリス、ウェ
 イ、20
 (74) 代理人 100127188
 弁理士 川守田 光紀
 (72) 発明者 クエ ョ
 シンガポール国, 120317, クレメン
 ティアベニュー 4, ブロック317, #
 11-103

最終頁に続く

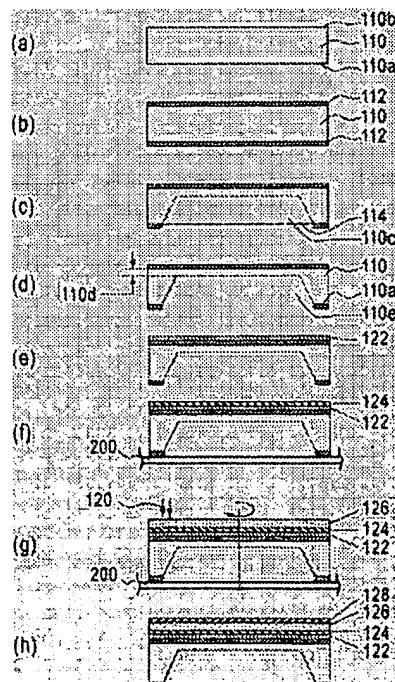
(54) 【発明の名称】微細加工電気機械素子

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】基板上に形成された圧電膜が製造プロセス中の損傷あるいは汚染などから十分保護され得る、MEMS素子用圧電膜構造を製造するための方法および装置を提供する。

【解決手段】基板110を用意するステップと、該基板の両面に酸化ケイ素膜112を形成した後、フォトリソグラフィ法により裏面の酸化ケイ素膜に開口114を設けるステップと、基板裏面をエッチングして微細構造を有する凹部110eを形成するステップと、この基板を凹部110eを下にして基板ホルダー200に搭載し回転しながら先駆物質溶液を前記基板前面110bに滴下し、薄膜層を表面に形成するステップとからなる。

【選択図】図1





National Center for Industrial Property Information and

News

This service is available to authorized industrial property offices only.

Any secondary use such as offering of translation service to the third party is prohibited.

Advanced Search	Search	Web Page	Text
-----------------	--------	----------	------

Search from JAPANESE Application/Priority/Publication/Patent NumberType Document Number

e.g.	Application Number	2001-123456 or H13-123456
	Priority Number	
	A, U (Kokai)	H12-123456 or 2000-123456
	B, U, U1, Y (Kokoku)	S46-123456
	A1	WO1998-123456 or WO98-123456
	B, U, Y	2500001

Display Type File Wrapper Information Patent Family

Note: Please select "Patent Family" when you search by PCT international application number corresponding file wrapper information is not directly accessible.

Search from OTHER Application/Priority NumberApplication Number Priority Number

e.g. US-1997-258122, WO-1998-US012345

Select up to 3 technical dictionaries in order of priority.Dictionary1 Dictionary2 Dictionary3

Copyright (C) 2003-2004 JPO a